



半导体行业点评：晶圆代工产 线满载运行 Q4龙头业绩增速 预期上行



Q3 半导体晶圆代工产线满载运行，2021 年晶圆代工市场规模增速预计高于 20%。业内大厂受益 Q4 业绩增速预期持续上行需求端下游需求恢复超预期叠加 5G、新能源汽车等新兴技术应用中的半导体含量增加，供给端产能预计于 2022 年末开始陆续释放，叠加新冠疫情引发的供应链中断尚未恢复，半导体市场供需失衡延续。ICinsights 预测 2021 年全球代工市场规模有望达 871 亿美元，同比增长 24%。

晶圆代工大厂 Q3 单季业绩保持中高速增长，Q4 业绩增速预测上行；新建产能于 2022 年中后期陆续释放。2021Q3 单季中芯国际营收为 92.81 亿元，同比增长 21.5%；毛利率为 33.1%，同比上升 8.9ppt。公司 FinFET 工艺流片项目产能利用率及营收继续提高；Q4 单季业绩指引营收预计约 103.02 亿元，同比增长约 54.53%。Q3 单季联电营收为 128.24 亿元（美元兑人民币汇率取值为 6.38），同比增长 14.7%；毛利率为 36.8%，同比上升 15ppt；Q4 业绩指引晶圆出货量增长 1%-2%，ASP 增长 1%-2%，单季营收预计同比增长约 20%。华虹半导体 12 英寸工艺平台 NORFlash 产品逐渐成为公司营收的新增长点，公司 Q3 单季营收为 30.11 亿元，同比增长 70.93%；毛利率为 27.1%，同比上行 2.9ppt。Q4 单季营收预期为 31.26 亿元，同比增长约 63.3%。台积电 Q3 单季营收 962.86 亿元，同比增长 16.34%；毛利率为 51.33%，同比下滑 2.1ppt；Q4 业绩指引单季营收为 1000 亿左右，季度营收同比增长 19.17%。

中芯国际在建产能为 finfet 先进工艺及 28nm 工艺制程，深圳 12 英

寸晶圆厂（14nm+工艺制程）有望于 2022 年下半年投产，北京月产能 10 万片的 12 吋晶圆厂首期预计 2024 年完工。联电 12 吋厂 28nm 工艺制程预计月产能扩增约 2.75 万片，预计投产时间为 2023Q2。华虹半导体 12 英寸晶圆厂（90-55nm 工艺制程）2022 年底月产能预计可达 9.5 万片。台积电发布的产能扩张集中于 5-3nm 先进制程和 22/28nm 制程，南京 28nm 晶圆厂扩产 2 万片于 2023 年中期放量，日本新建 22/28nm 晶圆厂预计于 2024 年中期投产。

投资建议

建议持续关注半导体行业。半导体行业供需失衡延续或延续至 2022 年中后期，提振业内龙头业绩；中长期国家政策支持叠加国产化替代加速，利好国内半导体龙头业绩、助推技术研发落地提速。物联网、新能源汽车等新兴拉动芯片市场需求，产业发展长期向好。建议重点关注功率半导体、晶圆代工、第三代半导体材料细分行业龙头。给予半导体行业“增持”评级。

风险提示

产能扩产不及预期；市场需求下滑；技术研发不及预期；宏观政策变化不及预期。

关键词: 5G 新能源 新能源汽车 物联网 疫情 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30269

